

# Mate 2010 第16回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」 シンポジウム 次世代製品へのブレークスルー技術 参加者募集

**主催:**(社) 溶接学会 マイクロ接合研究委員会  
**共催:**(社) 機械学会 エレクトロニクス実装における信頼性設計と熱制御に関する研究分科会, (社) 高温学会 微細加工研究情報委員会, (社) 日本塑性加工学会 接合・複合分科会, (社) 日本電気制御機器工業会, エレクトロニクス生産科学学会準備会, レーザ加工学会, 大阪大学 先端科学イノベーションセンター

**協賛:**映像情報メディア学会, エレクトロニクス実装学会, 応用物理学会, 化学工学会, 画像電子学会, 軽金属学会, 計測自動制御学会, 高温学会, 高分子学会, 資源・素材学会, システム制御情報学会, 情報処理学会, 精密工学会, 電気化学会, 電気学会, 電気設備学会, 電子情報通信学会, 日本機械学会, 日本金属学会, 日本顕微鏡学会, 日本材料学会, 日本シミュレーション学会, 日本接着学会, 日本セラミックス協会, 日本塑性加工学会, 日本伝熱学会, 日本非破壊検査協会, 日本表面科学学会, 日本品質管理学会, 日本複合材料学会, 日本物理学会, 日本分析化学会, 日本溶接協会, 表面技術協会, プラスチック成形加工学会

## 開催趣旨

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

**日時:**平成22年2月2日(火) 8:50～17:50  
平成22年2月3日(水) 9:00～17:30

**会場:**ワークピア横浜  
横浜市中区山下町24-1

シンポジウム参加登録費(論文集代を含む)

○主催・共催団体登録会社 : 20,000円  
○協賛学協会会員会社 : 30,000円  
○論文口頭発表者 : 15,000円  
○大学、国公立研究機関 : 10,000円  
○学生 : 5,000円  
○その他(一般) : 40,000円

## シンポジウム参加申込方法

下記シンポジウム URL より平成22年1月22日(金)までに参加登録を行って下さい。

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2010.html>

参加費のお支払いは、銀行振込・クレジットカードのいずれかでお願ひ致します。

問合せ、申込先 Mate 2010 事務局 事務代行  
合同会社フロンティア・アライアンス  
ものづくりリエゾンオフィス事業部  
TEL: 06-6878-5628, FAX: 06-6879-7568  
E-Mail: mate@fa-mlo.com

参加申込締切日:平成22年1月22日(金)

**振込先銀行:**三井住友銀行 千里中央支店  
口座番号:普通 0824444  
口座名:合同会社フロンティア・アライアンス  
ものづくりリエゾンオフィス

## シンポジウム URL

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2010.html>

## プログラム(セッション名と発表件数)

2月2日(火) 8:50～17:45 (17:45～懇親会)

### ●プレナリーセッション

「BEANS プロジェクトの特長と最新成果」

(技術研究組合 BEANS 研究所 安達 淳治)

「立体構造新機能集積回路(ドリームチップ)技術開発

—ドリームチッププロジェクト」

(技術研究組合 超先端電子技術開発機構 嘉田 守宏)

「太陽電池の研究開発動向

—太陽光発電未来技術研究開発プロジェクトを中心に」

(豊田工業大学 山口 真史)

2月2日（火） 8:50～17:45	2月3日（水） 9:00～17:30
[A-1] 品質・信頼性Ⅰ（5件） [A-2] 品質・信頼性Ⅱ（5件） [A-3] 疲労・熱疲労（5件） [B-1] ソルダペースト（5件） [B-2] むれ・溶解（5件） [B-3] 材料・界面反応（5件） [C-1] 基板・パッケージⅠ（講演1件+論文3件） [C-2] 基板・パッケージⅡ（4件）	[A-4] ナノマテリアル実装技術Ⅰ（講演1件+論文3件） [A-5] ナノマテリアル実装技術Ⅱ（講演1件+3件） [A-6] 鉛フリーはんだⅠ（5件） [A-7] 鉛フリーはんだⅡ（5件） [B-4] 樹脂実装・樹脂材料（講演1件+論文3件） [B-5] 3D実装（講演1件+論文4件） [B-6] フリップチップ（4件） [B-7] パワーモジュール（講演1件+論文3件） [C-4] 低音接合・常温接合（講演1件+論文3件） [C-5] レーザ微細加工（講演1件+4件） [C-6] MEMS（4件）  （一般論文発表合計86件）



## Best Author 賞 (JWS Best Author Award) の推薦について

下記により Best Author 賞の推薦を募集いたします。

本年第1号（1月号）から第8号（12月号）までに会誌に掲載された記事の中から優秀と認められるものを、巻号、題名、著者、推薦理由を記して、1編、編集委員会宛ご推薦下さい。

### 【賞の概要】

会誌「溶接学会誌」に発表された記事のうち、特に多数の会員の研鑽、及び、学術、技術の向上、普及に貢献した記事の著者に授与される。

### 【選考委員】

同賞選定委員会

委員長：会誌編集委員長

委員：編集委員より数名（各分野代表＋総合企画＋

副委員長）

### 【選考方法】

会誌編集委員および会員モニタの推薦による記事の中から選定委員会で選定する。

### 【選考基準】

溶接学会誌の本年第1号（1月号）から第8号（12月号）までに掲載された記事の中から、優秀と認められるものを、原則として毎年数編以内選定する。

### 【表彰等】

4月通常総会席上で表彰、賞状の贈呈。

### 【推薦書送付先】

（社）溶接学会 編集委員会宛



## WEB掲載の溶接学会論文集27巻(平成21年度)の印刷物の購入について

溶接学会論文集は、平成19年1月より印刷物での発刊に代わってホームページ上にてWEB版として発刊されております。

印刷物にて一年分を纏めたものを購入される方は、下記により、平成22年3月31日までにお申込み下さいますようお願いいたします。

溶接学会論文集27巻(平成21年度)

**【価格】** 15,000円/年1冊(税込・送料別)

**【申込先】** 「お名前(会社名)」「送付先住所」「冊数」  
をご明記の上、FAXにてお申込み下さい。

日本印刷出版株式会社 TEL: 06-6441-0075

FAX: 06-6443-5815

## 大阪大学 接合科学研究所 助教公募

### 1. 公募人員

助教 1名

### 2. 所属

大阪大学接合科学研究所 接合機構研究部門複合化機構学分野

### 3. 専門分野

粉末冶金法を基本とした材料の複合・多機能化と再利用・再資源化に関する基礎研究に取り組むと共に、その中において再生可能エネルギーの創出に向けた新規加工プロセスの構築に関する応用研究を積極的にできる方。

### 4. 応募資格

博士の学位または外国の Ph.D.を有する、あるいはそれらが着任時期までに取得見込みであること、英語能力に優れる方が望ましい。

### 5. 任期

7年（実績評価により再任可）

### 6. 提出書類

- (1) 履歴書（写真貼付）
- (2) 研究業績目録（査読付原著論文、国際会議論文、著

書、総説・解説、特許、その他に分類下さい。また原著論文がインパクトファクターを有する場合は、それも併記下さい。）

- (3) 主要論文別刷（5編以内、コピー可）
- (4) 科研費等外部資金獲得の状況
- (5) TOEIC あるいは TOEFL スコア（コピー可）
- (6) 研究業績の概要（1,000字程度）
- (7) 着任後の研究教育活動の抱負（1,000字程度）
- (8) 紹介可能な方2名の氏名と連絡先

### 7. 応募締切日

2010年2月26日（金）必着

### 8. 着任時期

2010年4月1日

### 9. 書類提出・問合せ先

〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘11-1

大阪大学接合科学研究所 近藤勝義

E-mail: kondoh@jwri.osaka-u.ac.jp

封筒に「助教応募書類」と朱書し、簡易書留で郵送下さい。なお、応募資料は返却致しません。